

DA 150A 粘接胶 产品数据表

高电导率

优异的耐湿性能

高可靠性

简介

DA 150A 是一款采用混合粉体填料体系的高导热、无溶剂、快速固化型热固性固晶胶。该产品对多种基材及裸芯片均具有优异的粘接性能, 适用于小尺寸及大尺寸芯片固晶应用. DA 150A 可通过点胶或印刷方式进行施胶, 并已在高温回流焊条件下展现出优异的可靠性与稳定性, 适用于高可靠性半导体封装工艺。

物理特性

产品名称	DA 150A 粘接胶
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	1.5 – 1.8 g/cm³
粘度 (ASTM D-1384)	0 – 50 kcP
固化材料特性	
玻璃化转变温度 Tg	118 °C
C.T. E (ASTM E 831), PPM/°C	32
导热系数 (W/mK)	2–5
杨氏模量(GPa)	2–3

提取离子(MIL-STD-883E)	
Na ⁺	< 5 ppm
K ⁺	<5 ppm
F ⁻	< 5 ppm
Cl ⁻	< 10 ppm
表面绝缘电阻(J-STD-004)	通过
芯片剪切强度	2x2毫米矽晶片(鍍鈀):2.0 2x2毫米鍍金矽晶片(裸銅基 底):2.5 2x2毫米鍍金矽晶片(鍍金基 底):2.3

推荐固化条件

150 °C 固化 6 – 10 分钟

注：固化时间不包含胶层位置升温至目标固化温度所需的时间。可根据具体工艺条件评估并采用其他固化曲线

储存与保质期

在 -40 °C 条件下、原厂密封容器中保存，保质期为 6 个月。超过建议储存期限可能导致粘度上升。请避免受潮、挥发及外来杂质污染，否则可能影响产品的加工性能。

安全

DA 150A 为环保、无毒材料。操作时建议遵循一般工业卫生规范。详细安全信息请参阅 SDS(安全数据表)。

包装

DA 150A 導電膠提供10cc 30cc包裝規格。其他包裝規格可依客戶需求提供。如需訂購信，請聯繫YINCAE公司。